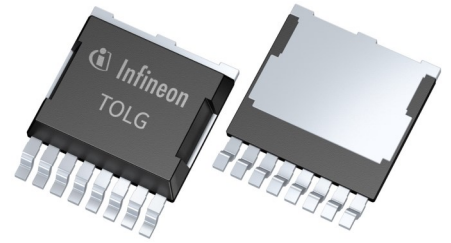


TOLGパッケージのOptiMOS™パワー-MOSFET



TOLGは、TOLxファミリーに新たに加わったパッケージで、TCoB（Thermal Cycling on Board Performance:基板実装時の熱サイクル試験）に対し優れた性能を実現しています。本パッケージは、TO-Leadless（TOLL）パッケージ同様に、大電流対応の薄型パッケージになっています。TOLGは、TO-Leadlessとフットプリント互換性があり、さらにガルウイングリードを採用することで高い温度サイクル耐量を実現しています。

TOLGの主な利点は、高効率、低EMI、高電力密度で、高い性能とシステム全体の効率化を実現します。

主な特長

- > 最高クラスのテクノロジー
- > 高い電流定格
- > リンギング及び電圧オーバーシュート
- > D2PAK 7ピン パッケージに比べて、ボードサイズを60%低減
- > ガルウイングリード

主な利点

- > 高性能
- > 高いシステム信頼性
- > 高効率及び低EMI
- > 高い電力密度
- > 優れたTCoB（Thermal Cycling on Board Performance:基板実装時の熱サイクル試験）

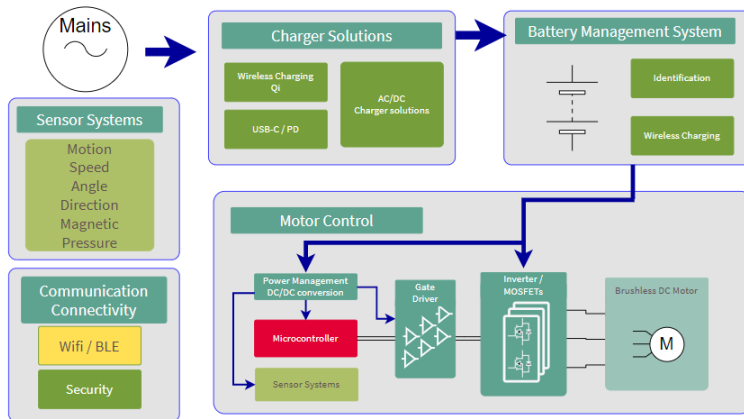
競合製品に対する優位性

- > TOLLパッケージや標準的な要求事項（IPC- 9701）に対して、Al-IMS（アルミニウム製絶縁金属基板）上で優れたTcoBを実現

対象アプリケーション

- > 電気スクーター
- > 小型電気自動車（LEV）
- > フォークリフト
- > パワーツール、ガーデニング ツール
- > バッテリー管理システム
- > ホット スワップ

システム図



製品関連情報/オンラインサポート

[製品ファミリー ページ](#)

製品概要および製品データシート ページへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IPTG007N06NM5ATMA1	SP005430755	PG-HSOG-8
IPTG011N08NM5ATMA1	SP005430759	PG-HSOG-8
IPTG014N10NM5ATMA1	SP005430771	PG-HSOG-8
IPTG111N20NM3FDATMA1	SP005431194	PG-HSOG-8
IPTG210N25NM3FDATMA1	SP005431198	PG-HSOG-8

【TOLGパッケージのOptiMOS™パワー-MOSFET】

FAQ

What is the lead time for StrongIRFET™ 2 MOSFETs?

- Lead time for StrongIRFET™ 2 MOSFETs is ~13weeks.

What is the main difference between StrongIRFET™ and OptiMOS™ MOSFET technologies?

- The key difference between the 2 technologies is mainly based on the reliability level: StrongIRFET™ fulfills standard qualification requirements while OptiMOS™ meets industrial requirements.